

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 1 月 13 日(13.01.2011)



PCT



(10) 国際公開番号
WO 2011/004706 A1

(51) 国際特許分類:

C08G 59/40 (2006.01) *C09J 179/08* (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) *H01L 21/60* (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08L 79/08 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/060622

(22) 国際出願日: 2010 年 6 月 23 日(23.06.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2009-163403 2009 年 7 月 10 日(10.07.2009) JP
特願 2010-119026 2010 年 5 月 25 日(25.05.2010) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東
レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP];
〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番
1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤丸 浩一
(FUJIMARU, Koichi) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大
津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋
賀事業場内 Shiga (JP). 野中敏央(NONAKA, Toshi-
hisa) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目
1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga

(JP). 龍田 佳子 (TATSUTA, Yoshiko) [JP/JP]; 〒
5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東
レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, ADHESIVE SHEET, CIRCUIT BOARD AND SEMICONDUCTOR DEVICE BOTH
PRODUCED USING THESE, AND PROCESSES FOR PRODUCING THESE

(54) 発明の名称: 接着組成物、接着シート、それらを用いた回路基板および半導体装置ならびにそれらの
製造方法

(57) Abstract: Provided is an adhesive composition having both excellent storability and excellent connection reliability. The ad-
hesive composition comprises (a) a polyimide soluble in organic solvents, (b) an epoxy compound, (c) particles of a curing accel-
erator, and (d) inorganic particles, the amounts of the organic-solvent-soluble polyimide (a) and the curing-accelerator particles
(c) being 15-90 parts by weight and 0.1-50 parts by weight, respectively, per 100 parts by weight of the epoxy compound (b), and
the content of the inorganic particles (d) being 30-80 wt.% of the total amount of (a) to (d).

(57) 要約: 保存性と接続信頼性の両方の特性に優れた接着組成物として、(a) 有機溶剤可溶性ポリイ
ミド、(b) エポキシ化合物、(c) 硬化促進剤粒子および(d) 無機粒子を含有し、(b) エポキシ
化合物 100 重量部に対し、(a) 有機溶剤可溶性ポリイミドの含有量が 15~90 重量部、(c) 硬
化促進剤粒子の含有量が 0.1~50 重量部であり、(d) 無機粒子の含有量が(a)~(d) 全量に
対して 30 重量%以上、80 重量%以下である接着組成物を提供する。

WO 2011/004706 A1